# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 6月 3日

出願番号

Application Number:

特願2003-157951

[ ST.10/C ]:

[JP2003-157951]

出 願 人 Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 6月23日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

J0099050

【提出日】

平成15年 6月 3日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 1/00

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

小山 俊介

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100091823

【弁理士】

【氏名又は名称】

櫛渕 昌之

【選任した代理人】

【識別番号】

100101775

【弁理士】

【氏名又は名称】 櫛渕 一江

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-266323

【出願日】

平成14年 9月12日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

044163

(【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0202069

【プルーフの要否】 要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 アンテナ装置、プリント配線板、プリント基板、通信アダプタ および携帯型電子機器

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長の略1/4 以上の長さを有するグランド部材と、

前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に 接地されたアンテナエレメントと、

を備えたことを特徴とするアンテナ装置。

【請求項2】 請求項1記載のアンテナ装置において、

前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されていることを特徴とするアンテナ装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載のアンテナ装置において、 前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、を備え

前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長逆Fアンテナとして機能することを特徴とするアンテナ装置。

【請求項4】 請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のアンテナ装置に おいて、

前記グランド部材は、電子回路を覆うことによりシールドするシールド部材と して構成されていることを特徴とするアンテナ装置。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のアンテナ装置に おいて、

前記グランド部材と前記アンテナエレメントとは、一体に形成されていること を特徴とするアンテナ装置。

【請求項6】 所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長の略1/4 以上の長さを有するグランド部材と、

前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に 接地されたアンテナエレメントと、 を備え、

前記グランド部材および前記アンテナエレメントは、プリント配線として形成 されていることを特徴とするプリント配線板。

【請求項7】 請求項6記載のプリント配線板において、

前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されていることを特徴とするプリント配線板。

【請求項8】 請求項6または請求項7記載のプリント配線板において、 前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、を備え

前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長逆Fアンテナとして機能することを特徴とするプリント配線板。

【請求項9】 請求項6ないし請求項8のいずれかに記載のプリント配線板において、

前記グランド部材と前記アンテナエレメントとは、一体に形成されていること を特徴とするプリント配線板。

【請求項10】 プリント配線板と、

前記プリント配線板上に配置された電子回路と、

所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長略4分の1以上の長さを有す るグランド部材と、

前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に 接地されたアンテナエレメントと、

を備えたことを特徴とするプリント基板。

【請求項11】 請求項10記載のプリント基板において、

前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されていることを特徴とするプリント基板。

【請求項12】 請求項10または請求項11記載のプリント基板において

前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、を備え

前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長逆Fアンテナとして機能することを特徴とするプリント基板。

【請求項13】 請求項10ないし請求項12のいずれかに記載のプリント 基板において、

前記アンテナエレメントと前記グランド部材と一体形成部品であることを特徴 とするプリント基板。

【請求項14】 請求項10ないし請求項12のいずれかに記載のプリント 基板において、

前記アンテナエレメントは前記プリント配線板にプリント配線として形成され、前記グランド部材は前記プリント配線板とは別部品であることを特徴とするプリント基板。

【請求項15】 請求項13または請求項14のいずれかに記載のプリント 基板において、

前記グランド部材は、前記電子回路を覆うことによりシールドするシールド部 材として構成されていることを特徴とするプリント基板。

【請求項16】 請求項15に記載のプリント基板において、

前記プリント配線板上に形成され、前記グランド部材に電気的に接続されたグランドパターンを備えたことを特徴とするプリント基板。

【請求項17】 請求項10ないし請求項12のいずれかに記載のプリント 基板において、

前記アンテナエレメントと前記グランド部材とは前記プリント配線板にプリント配線として形成されていることを特徴とするプリント基板。

【請求項18】 プリント配線板と、

前記プリント配線板上に配置された電子回路と、

所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長略4分の1以上の長さを有するグランド部材と、

前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に 接地されたアンテナエレメントと、

コネクタ接続端子部と、を備え、

前記コネクタ接続端子部は、前記プリント配線板に対し、前記アンテナエレメントを構成するアンテナエレメント本体の延在方向側に配置される、

ことを特徴とする通信アダプタ。

【請求項19】 請求項18記載の通信アダプタにおいて、

前記アンテナエレメントは、給電端子を備え、

前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して逆Fアンテナとして 機能することを特徴とする通信アダプタ。

【請求項20】 請求項1ないし請求項5のいずれかに記載のアンテナ装置を備えたことを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項21】 請求項20記載の携帯型電子機器において、

当該携帯型電子機器は、腕時計型に形成されていることを特徴とする携帯型電子機器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、アンテナ装置、プリント配線板、プリント基板、通信アダプタおよび携帯型電子機器に係り、特に高周波無線機器に用いられるアンテナ装置、プリント配線板、プリント基板、通信アダプタおよび携帯型電子機器に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

従来、携帯電話などの高周波無線機器である携帯機器用のアンテナとして、ヘ リカルダイポールアンテナが用いられている。

このヘリカルダイポールアンテナは、携帯機器の筐体から引き出して使用した り、筐体内に収納した状態で用いるように構成されていた。

[0003]

また、特許文献1に開示されているように、ヘリカルダイポールアンテナとは 別に携帯機器の筐体内に第2のアンテナを設けたものも提案されている。この構 成によれば、ヘリカルダイポールアンテナおよび第2のアンテナによりダイバー シティ (空間ダイバーシティや角度ダイバーシティ)を構成することもできる 。このような第2のアンテナとしては、逆Fアンテナが一般的に用いられている

また、2.4 [GHz] 帯カードタイプの薄型携帯機器には、セラミックを用いたチップアンテナが用いられている。

一方、携帯機器用のアンテナをプリント配線板上に形成する場合には、理想的にはアンテナエレメント周囲には十分な空間を確保することが特性確保の観点からは好ましい。これを容易に実現するためには、プリント配線板の表面にアンテナエレメントを形成するのが一般的であった。

#### 【特許文献1】

特開平3-175826号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来のヘリカルダイポールアンテナは、原理的にそのサイズが大きくなり、腕時計サイズの携帯型電子機器など、さらに小型化が要求される機器に対しては、適用しがたいという問題点があった。

また、逆Fアンテナは、アンテナエレメントとグランド板(接地板)とが所定の物理的配置をとることにより機能を発揮できる構造となっており、配置上の自由度が乏しい。さらに、グランド板の面積は逆Fアンテナの特性を左右しており、面積を低減させると特性が劣化する。このため、装置の小型化などの要求に伴い、プリント配線板の面積を小さくすべく、部品の実装密度をあげる必要が生じた場合には、部品の実装面積によってプリント配線板の面積を消費してしまい、グランド板の面積を確保することができず、逆Fアンテナとして所望の特性が得られなくなってしまうという問題点があった。

[0005]

また、セラミックのチップアンテナは、チップアンテナ自身は面実装可能な程度の大きさである。しかしながら、チップアンテナの実装時においては、アンテナの所望の特性を得るためにグランド面積を大きく確保する必要があり、周辺回路およびグランドを含んだアンテナ装置全体としては、大きくなってしまうという問題点があった。さらにチップアンテナは高価であるという問題点もあった。

そこで、本発明の目的は、アンテナの特性(特に感度)を確保しつつ、回路全体の実装密度の向上およびプリント配線板の小型化を図ることが可能なアンテナ装置、プリント配線板、プリント基板、通信アダプタおよび携帯型電子機器を提供することにある。

[0006]

# 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、アンテナ装置は、所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長の略 1 / 4 以上の長さを有するグランド部材と、前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に接地されたアンテナエレメントと、を備えたことを特徴としている。

この場合において、前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状 に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されているようにしてもよい。

また、前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、 を備え、前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長 逆Fアンテナとして機能するようにしてもよい。

さらに、前記グランド部材は、電子回路を覆うことによりシールドするシール ド部材として構成されているようにしてもよい。

さらにまた、前記グランド部材と前記アンテナエレメントとは、一体に形成されているようにしてもよい。

[0007]

また、プリント配線板は、所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長の略1/4以上の長さを有するグランド部材と、前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に接地されたアンテナエレメントと、を備え、前記グランド部材および前記アンテナエレメントは、プリント配線として形成されていることを特徴としている。

この場合において、前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状 に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されているようにしてもよい。

また、前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、 を備え、前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長 逆Fアンテナとして機能するようにしてもよい。

さらに、前記グランド部材と前記アンテナエレメントとは、一体に形成されて いるようにしてもよい。

[0008]

また、プリント基板は、プリント配線板と、前記プリント配線板上に配置された電子回路と、所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長略4分の1以上の長さを有するグランド部材と、前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に接地されたアンテナエレメントと、を備えたことを特徴としている。

この場合において、前記アンテナエレメントは、前記グランド部材の端部形状 に沿って所定距離離間して略同一平面上に配置されているようにしてもよい。

また、前記アンテナエレメントは、アンテナエレメント本体と、給電端子と、 を備え、前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して4分の1波長 逆Fアンテナとして機能するようにしてもよい。

さらに、前記アンテナエレメントと前記グランド部材と一体形成部品であるようにしてもよい。

さらにまた、前記アンテナエレメントは前記プリント配線板にプリント配線と して形成され、前記グランド部材は前記プリント配線板とは別部品であるように してもよい。

また、前記グランド部材は、前記電子回路を覆うことによりシールドするシールド部材として構成されているようにしてもよい。

さらに、前記プリント配線板上に形成され、前記グランド部材に電気的に接続 されたグランドパターンを備えるようにしてもよい。

さらにまた、前記アンテナエレメントと前記グランド部材とは前記プリント配 線板にプリント配線として形成されているようにしてもよい。

また、通信アダプタは、プリント配線板と、前記プリント配線板上に配置された電子回路と、所定の方向軸に沿って、通信に用いる電波の波長略4分の1以上の長さを有するグランド部材と、前記方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、前記グランド部材に接地されたアンテナエレメントと、コネクタ接続

端子部と、を備え、前記コネクタ接続端子部は、前記プリント配線板に対し、前 記アンテナエレメントを構成するアンテナエレメント本体の延在方向側に配置さ れる、ことを特徴としている。

この場合において、前記アンテナエレメントは、給電端子を備え、前記アンテナエレメント本体と前記給電端子とは共働して逆Fアンテナとして機能するようにしてもよい。

また、携帯型電子機器は、上記いずれかのアンテナ装置を備えたことを特徴としている。

この場合において、当該携帯型電子機器は、腕時計型に形成されているように してもよい。

[0009]

【発明の実施の形態】

次に図面を参照して本発明の好適な実施の形態について説明する。

## [1] 第1実施形態

図1は第1実施形態のアンテナ装置が実装されたプリント基板10の組み立て図である。図2は、第1実施形態のプリント基板10の上面図である。図3は、第1実施形態のプリント基板10の正面図である。図4は、第1実施形態のプリント基板10の側面図である。

図1ないし図4において、プリント配線板11は、回路部品14等が実装されており、プリント配線板11の表面(及び多層基板の場合には内層)に配線用の電極パターンが形成されている。プリント配線板11の上面には、シールド部材13が半田付けされるグランド(接地)パターン11Aが形成され、アンテナ装置の実装時にはシールド部材13が半田付けされる。シールド部材13が半田付けされるグランドパターン11Aは、プリント配線板11のグランドパターン上面に形成されたハンダ付け防止用のレジストを除去することにより形成されるのが一般的である。

高周波回路のプリント基板においては、図1に示すごとく通常、複数の個所にてシールド部材13がプリント配線板11に半田付けされる。また、プリント配線板11としては、多層基板のみならず、単層基板であってもかまわない。

アンテナエレメント12は、プリント配線板11に対して略平行に設けられており、本第1実施形態の場合、給電端子(給電点)12Bがプリント配線板11と電気的に接続されるとともに、アンテナエレメント本体12Aを支持する状態となっている。

#### [0010]

アンテナエレメント12は、シールド部材13と一体に形成されており、折り曲げ部分の形状および寸法を工夫することで、1枚の金属板からシールド部材1 3及びアンテナエレメント12を一括して得ることが出来る。

アンテナ本体支持部12Cは、給電端子12Bとプリント配線板11に垂直な方向の長さが同じであり、基板実装時にはアンテナエレメント12を基板上で支えることとなる。その結果、アンテナエレメント本体12Aは、基板と水平に、かつ、シールド部材13の平面部と同一平面内に保たれる。シールド部材折曲部13Aも給電端子12Bあるいはアンテナ本体支持部12Cとプリント配線板11に垂直な方向の長さが同じであり、シールド部材13の平面部を基板に対し水平に固定、支持する。なお、図1中、他のシールド部材折曲部についても、プリント配線板11に垂直な方向の長さが同一である。

#### [0011]

ここで、アンテナエレメント12に流れる電流分布に影響を与えないようにするには、アンテナ本体支持部12Cはアンテナエレメント本体12Aに対し垂直に形成される必要がある。この場合において、プリント配線板11のアンテナエレメント12下部には、多層基板の場合の内層も含めて、グランドなど電流が流れる電流流路を設けないことが望ましい。アンテナエレメント半田付けパターン11Cはアンテナ本体支持部12Cの先端部分をプリント配線板11上で半田付け固定する為のパターンであって、他の配線とは電気的に接続されてはいない。

一方、アンテナ本体支持部12Cと同様にアンテナエレメント本体12Aに垂直に形成されている給電端子12Bは、プリント配線板11上の半田付けパターン11Bに半田付けされる。ハンダ付けパターン11Bは給電端子12Bを半田付けによりプリント配線板11上に固定すると共に、その一端がプリント配線板11上に形成された回路の信号給電点に電気的に接続されている。これにより、

図示しない無線回路の送信信号、受信信号がアンテナと無線回路間でそれぞれ伝達される。

[0012]

また、アンテナエレメント12は、銅などの導電性の高い材料が望ましい。しかしながら、表面のメッキに導電性の高い材料を用いるように構成することも可能である。

シールド部材13は、回路部品14を電磁的にシールド(遮蔽)するためのものであり、回路部品14等の回路部品及び配線パターン(図示せず)の周囲を覆っている。ここで、回路部品14としては、半導体集積回路、1608サイズ(外形1.6mm×0.8mm)、1005サイズ(外形1.0mm×0.5mm)、0603(外形0.6mm×0.3mm)サイズなどのチップ部品が一般的である。

シールド部材13は、シールド部材折曲部13Aにおいて、プリント配線板1 1上に形成されているグランド(接地)パターン11Aに接続されている。

[0013]

ところで、アンテナ装置のグランドは、理想的にはその面積が大きい方が逆F アンテナの特性的な観点からは好ましい。そのため、現実的には、プリント配線 板11の表面積において可能な限り大きく設けるのが好ましい。

しかしながら、実際的には、装置の小型化の観点からは、プリント配線板11 の大きさには上限がある。ひいては、グランド部材の実効面積も制限を受けることとなる。

そこで、本第1実施形態においては、アンテナ装置の性能を向上させつつ、グランド部材の実効面積を低減すべく、通信に用いる電波の波長をλとし、グランド部材として機能するシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さLを略1/4λ(4分の1波長)としている。もちろん略1/4λ(4分の1波長)以上

の長さを有するグランド部材としてもよいが、設置面積の観点からはシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さを略1/4λ(4分の1波長)とするのが好ましい。さらにアンテナエレメント12の主要部の中心軸Yは、方向軸Xと略直交する方向に延在するように配置されている。

さらに、本第1実施形態においては、回路部品14等の回路部品及び配線パターンを電磁的にシールドするために接地されているシールド部材13をアンテナエレメント12のグランドとして用いるようにしている。この場合において、グランドの実効面積は、図1のシールド部材13のプリント配線板11上に占める面積にほぼ等しい。

すなわち、回路部品 1 4 等の回路部品及び配線パターンの状態に拘わらず、グランド面積を確保する事が可能となる。換言すれば、プリント配線板 1 1 上に十分な面積のグランドパターンを形成できない場合であっても、アンテナ特性を得る為に十分なグランド面積を確保することが可能となる。

#### [0014]

図5は第1実施形態のアンテナ装置の放射特性図である。また、図6は比較対象としてのダイポールアンテナの放射特性図である。さらに図7は、比較対象としてのグランド部材として機能するシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さを略 $1/4\lambda$ (4分の1波長)未満とした場合のアンテナ装置の放射特性図である。

図5および図6において、外周部分に配置している $1\sim1$ 6の数字は一周36 0度を16等分した各方向を表しており、隣り合う二つの数字の表す実際の角度間隔は22.5度である。また図内の数値(dB値)はダイポールアンテナ比(dBd)である。また、Horiは水平方向(Horizontal)の特性を示し、Vertは垂直方向(Vertical)の特性を示す。

図5に示すように、本第1実施形態のアンテナ装置によれば、指向特性はダイポールアンテナと90[°] 異なるものの、放射特性は図6に示すダイポールアンテナと比較して同等あるいは数dB以内の放射特性劣化にとどまっており、非常に優秀な放射特性を得ることができた。

これに対し所定の方向軸Xに沿ったグランド部材として機能するシールド部材

13の長さを略1/42(4分の1波長)未満とした場合には、図7に示すように、放射特性は図5のダイポールアンテナと比較して10dB以上の放射特性劣化となっており、アンテナ装置としての性能が低下していることがわかる。

[0015]

## [2] 第2実施形態

上記第1実施形態においては、アンテナエレメントとシールド部材とを一体に 構成していたが、本第2実施形態はアンテナエレメントとシールド部材とを別体 に構成した場合の実施形態である。

図8は第2実施形態のアンテナ装置が実装されたプリント基板の組み立て図である。図9は、第2実施形態のプリント基板の上面図である。図10は、第2実施形態のプリント基板の正面図である。

図8ないし図10に示すように、プリント基板20を構成するプリント配線板21の上面、大別するとアンテナエレメント22、シールド部材23および回路部品24が配置されている。

この場合においても、第1実施形態と同様に、プリント配線板21としては、 単層基板のみならず、多層基板であってもかまわない。

[0016]

アンテナエレメント22は、プリント配線板21に対して3次元的に略平行に設けられており、本第2実施形態の場合、給電端子(給電点)22Bがプリント配線板21と半田付けパターン21Bにおいて半田付けにより接続されるとともに、アンテナ本体支持部22Cが半田付けパターン21Cにおいて半田付けされる。エレメント半田付けパターン21Cは、アンテナ本体支持部22Cの先端部分を基板上で半田付け固定する為のパターンであって、他の配線とは電気的に接続されていない。

この結果、給電端子22Bおよびアンテナ本体支持部22Cによりアンテナエレメント本体22Aが支持されている。また、アンテナ本体支持部22Cは図に示すごとくエレメントの両側に複数設けることでアンテナの位置を安定化させることが出来る。アンテナエレメント22の一方の端点はシールド部材23に半田付け、蝋付け等で電気的、機械的に接続されている。

第1実施形態と同様に、アンテナエレメント22は、銅などの導電性の高い材料が望ましいが、表面のメッキに導電性の高い材料を用いるように構成することも可能である。

上記構成の結果、アンテナエレメント本体 2 2 A、給電端子 2 2 B およびアンテナ本体支持部 2 2 C は、協働して、逆 F アンテナとして機能している。給電端子 2 2 B のアンテナエレメント本体 2 2 A への接続位置は、逆 F アンテナの 1 / 4  $\lambda$  (4分の 1 波長)におけるインピーダンスが所定の値(例えば、5 0  $[\Omega]$ )となる位置に設定されている。

### [0017]

シールド部材23は、回路部品24を電磁的にシールド(遮蔽)するためのものであり、回路部品24等の回路部品及び配線パターンの周囲を覆っている。

さらにシールド部材23は、シールド部材折曲部23Aにおいて、プリント配線板21上に形成されているグランド(接地)パターン21Aに上述した第1実施形態と同様に接続されている。

#### [0018]

本第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、アンテナ装置の性能を向上させつつ、グランド部材の実効面積を低減すべく、通信に用いる電波の波長を $\lambda$ とし、グランド部材として機能するシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さLを略1/4 $\lambda$ (4分の1波長)としている。もちろん略1/4 $\lambda$ (4分の1波長)以上の長さを有するグランド部材としてもよいが、設置面積の観点からはシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さを略1/4 $\lambda$ (4分の1波長)とするのが好ましい。さらにアンテナエレメント12の主要部の中心軸Yは、方向軸Xと略直交する方向に延在するように配置されている。

これらの結果、本第2実施形態によっても、アンテナ装置の特性を向上させつ つプリント基板の面積を低減させることができる。

# [0019]

また、回路部品24等の回路部品及び配線パターンを電磁的にシールドするために接地されているシールド部材23をアンテナエレメント22のグランドとして用いているので、回路部品24等の回路部品及び配線パターン(図示せず)の

配置状態に拘わらず、グランド面積を確保する事が可能となり、プリント配線板 2 1 上に十分なグランドパターンを形成できない場合であっても、十分なグラン ド面積を確保することが可能となる。

さらに本第2実施形態によれば、アンテナエレメント22とシールド部材23 とを別体に構成しているので、アンテナエレメント22とシールド部材23との 結合工程が増えるものの、それぞれを別個に加工でき、加工が容易となる。加え て、様々な製品態様に容易に対応することが可能となる。

[0020]

# [3] 第3実施形態

上記各実施形態においては、アンテナエレメントは、プリント配線板とは別個 に構成していたが、本第3実施形態は、アンテナエレメントをプリント配線板上 にプリントアンテナ(配線パターン)として形成した場合の実施形態である。

図11は第3実施形態のアンテナ装置が実装されたプリント基板の組み立て図 である。図12は、第3実施形態のプリント基板の上面図である。図13は、第 3 実施形態のプリント基板の正面図である。

図11に示すように、プリント基板30を構成するプリント配線板31の上面 には、大別するとアンテナエレメント本体32Aが配線パターンとして形成され て配置されるとともに、シールド部材33および回路部品34等の回路部品及び 配線パターン(図示せず)が配置されている。

この場合においても、上記各実施形態と同様に、プリント配線板31としては 、単層基板のみならず、多層基板であってもかまわない。

[0021]

アンテナエレメント本体32Aは、プリント配線板31上にプリント配線とし て設けられており、給電端子(給電点)32Bがプリント配線板31上の給電用 配線に電気的に接続されるとともに、アンテナエレメント本体32Aの一端はプ リント配線板31上に形成されたグランドパターン31Aに接続されている。こ の場合、同一のグランドパターンとして連続的にパターンを形成することが出来

また、プリント配線板31上に形成されたグランドパターン31Aのアンテナエ

レメント本体32Aに向かい合う部分はアンテナエレメント本体32Aと略平行に一定の間隔を置いて形成されている。また、アンテナエレメント本体32Aのグランドパターン31Aと接続される部分は、グランドパターンに対して垂直に接続されている。

上記構成の結果、アンテナエレメント本体32Aおよび給電端子32Bは、協働して、逆Fアンテナとして機能している。給電端子32Bのアンテナエレメント32への接続位置は、逆Fアンテナのインピーダンスが所定の値(例えば、50[Ω])となる位置に設定されている。

[0022]

シールド部材33は、回路部品34等の回路部品及び配線パターンを電磁的に シールド(遮蔽) するためのものであり、回路部品34等の回路部品及び配線パターン(図示せず)の周囲を覆っている。

さらにシールド部材33は、シールド部材折曲部33Aにおいて、プリント配線板31上に形成されているグランド(接地)パターン31Aに前記第1の実施 形態と同様に接続されている。

本第3実施形態においても、上記各実施形態と同様に、アンテナ装置の性能を向上させつつ、グランド部材の実効面積を低減すべく、通信に用いる電波の波長を $\lambda$ とし、グランド部材として機能するシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さLを略 $1/4\lambda$ (4分の1波長)としている。もちろん略 $1/4\lambda$ (4分の1波長)以上の長さを有するグランド部材としてもよいが、設置面積の観点からはシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さを略 $1/4\lambda$ (4分の1波長)とするのが好ましい。さらにアンテナエレメント本体32Aの主要部の中心軸Yは、方向軸Xと略直交する方向に延在するように配置されている。

[0023]

さらに上記各実施形態と同様に、回路部品34等の回路部品及び配線パターンを 電磁的にシールドするために接地されているシールド部材33をアンテナエレメ ント32のグランドとして用いているので、回路部品34等の回路部品及び配線 パターンの配置状態に拘わらず、グランド面積を確保する事が可能となり、プリ ント配線板31上に十分な面積のグランドパターンを形成できない場合であって も、十分なグランド面積を確保することが可能となる。

さらに本第3実施形態によれば、アンテナエレメント32をプリント配線としてプリント配線板の作成時に設けることができるので、製造工程の簡略化が可能となる。

[0024]

### [4] 第4実施形態

上記第3実施形態においては、アンテナエレメントをプリント配線板上にプリントアンテナ(配線パターン)として形成した場合の実施形態であったが、さらに本第4実施形態は、グランド部材をグランドパターンとしてプリント配線板に形成した場合の実施形態である。

図14は第4実施形態のアンテナ装置が実装されたプリント基板の上面図である。図15は図14のプリント基板の正面図である。

図14および図15に示すように、プリント基板40を構成するプリント配線板41の上面側には、大別するとアンテナエレメント42およびグランドパターン43が配線パターンとして形成されて配置されるとともに、回路部品44が配置されている。

この場合においても、上記各実施形態と同様に、プリント配線板41としては、単層基板のみならず、多層基板であってもかまわない。さらに多層基板である場合には、グランドパターン43を必要に応じて内層に形成することも可能である。

[0025]

アンテナエレメント本体42Aは、プリント配線板41上にプリント配線として設けられており、給電端子(給電点)42Bがプリント配線板41の図示しない給電用配線に電気的に接続されるとともに、接地端子(接地点)42Cがグランドパターン43に電気的に接続されている。

この場合に、アンテナエレメント本体42Aは、プリント配線の表面に導電性 の高い材料を用いてメッキを施せば、より性能の向上が図れる。

上記構成の結果、アンテナエレメント本体42A、給電端子42Bおよび接地端子42Cは、協働して、逆Fアンテナとして機能している。給電端子42Bの

アンテナエレメント本体42Aへの接続位置は、逆Fアンテナのインピーダンスが所定の値(例えば、 $50[\Omega]$ )となる位置に設定されている。

グランドパターン43は、回路部品44の周囲に適宜配置されるのが一般的である。

この場合、所定の方向X軸に沿って可能な限りグランドパターンを連続的に設けることが好ましい。このような目的のためには多層基板を用いるとグランドが形成しやすい。

[0026]

本第4実施形態においても、上記各実施形態と同様に、アンテナ装置の性能を向上させつつ、グランド部材の実効面積を低減すべく、通信に用いる電波の波長をλとし、グランド部材として機能するグランドパターン43の所定の方向軸Xに沿った長さLを略1/4λ(4分の1波長)としている。もちろん略1/4λ(4分の1波長)以上の長さを有するグランド部材としてもよいが、設置面積の観点からはグランドパターン43の所定の方向軸Xに沿った長さを略1/4λ(4分の1波長)とするのが好ましい。さらにアンテナエレメント42の主要部の中心軸Yは、方向軸Xと略直交する方向に延在するように配置されている。

さらに本第4実施形態によれば、アンテナエレメント42およびグランドパターン43をプリント配線としてプリント配線板の作成時に設けることができるので、製造工程の簡略化が可能となる。

[0027]

[5] 第1実施形態~第4実施形態の変形例

## [5.1] 第1変形例

以上の説明においては、シールド部材は、アンテナエレメントの配置部分を除き、プリント配線板の全体にわたって回路部品を覆っていたが、プリント配線板上に余裕がある場合には、シールド部材に電気的にグランドパターンを接続した状態でプリント配線板上に形成するようにし、シールド部材とグランドパターンとでグランド面積を確保するように構成することも可能である。

[0028]

[5. 2] 第2変形例

以上の説明においては、アンテナエレメントがシールド部材形状に沿って、折れ線形状を有する場合であったが、シールド部材の形状に沿った形状であれば、すなわち、シールド部材端部の形状に平行な形状であれば曲線形状や他の形状とすることも可能である。この場合に、アンテナエレメント内を流れる電流の微視的な電流方向をベクトルとして考え、このベクトルが部品、配線パターンあるいはパッド内を流れる電流のベクトル (微視的な電流方向) とできる限り平行とならないように、アンテナエレメントパターン周囲の部品、配線パターンあるいはパッドの位置を設定するようにすればより効果的である。

[0029]

## [5.3] 第3変形例

以上の説明においては、アンテナ装置および当該アンテナ装置を備えたプリント基板について説明したが、プリント配線板においても、通信に用いる電波の波長をλとし、所定の方向軸に沿って略1/4λ(以上)の長さを有するグランド部材と、方向軸と略直交する方向に延在するように配置され、グランド部材に接地されたアンテナエレメントと、を備え、グランド部材およびアンテナエレメントは、プリント配線として形成されているようにすれば、同様の効果を得ることが可能である。

[0030]

## [5.4] 第4変形例

以上の説明においては、アンテナエレメントの機械的な寸法については、詳細に述べなかったが、基本的に所望の周波数において4分の1波長となるように形成することが望ましい。

[0031]

## [6] 他の実施形態

次に前述の第1~第4実施形態及び変形例に記載したプリント基板(アンテナ 装置およびプリント配線板)を用いて電子機器完成品を構成する場合の第4~第 6実施形態について説明する。

[0032]

# [6.1]第4実施形態

図16は、携帯電話端末に接続して用いる通信アダプタモジュール70の説明図である。

図16に示すように、プリント基板50を構成するプリント配線板51の上面には、大別するとアンテナエレメント52が配線パターンとして形成されて配置されるとともに、シールド部材53および回路部品54等の各種回路部品及び配線パターン(図示せず)が配置されている。

この場合においても、上記各実施形態と同様に、プリント配線板51としては 、単層基板のみならず、多層基板であってもかまわない。

[0033]

アンテナエレメント本体52Aは、プリント配線板51上にプリント配線として設けられており、給電端子(給電点)52Bがプリント配線板51上の給電用配線に電気的に接続されるとともに、アンテナエレメント本体52Aの一端はプリント配線板51上に形成されたグランドパターン51Aに接続されている。この場合、同一のグランドパターンとして連続的にパターンを形成することが出来る。

また、プリント配線板51上に形成されたグランドパターン51Aのアンテナエレメント本体52Aに向かい合う部分はアンテナエレメント本体52Aと略平行に一定の間隔を置いて形成されている。また、アンテナエレメント本体52Aのグランドパターン51Aと接続される部分は、グランドパターン51Aに対して垂直に接続されている。

[0034]

上記構成の結果、アンテナエレメント本体 5 2 A、給電端子 5 2 Bは、協働して、逆Fアンテナとして機能している。給電端子 5 2 Bのアンテナエレメント本体 5 2 Aへの接続位置は、逆Fアンテナのインピーダンスが所定の値(例えば、5 0 [Ω])となる位置に設定されている。

シールド部材53は、回路部品54等の回路部品及び配線パターン(図示せず)を電磁的にシールド(遮蔽)するためのものであり、回路部品54等の回路部品及び配線パターンの周囲を覆っている。

さらにシールド部材53は、シールド部材折曲部53Aにおいて、プリント配

線板51上に形成されているグランド(接地)パターン51Aに前記第3の実施 形態と同様に接続されている。

[0035]

さらにプリント配線板51の一端にはコネクタ接続端子部55が設けられている。

この場合において、コネクタ接続端子部55は、アンテナエレメント本体52 Aの延在方向(図中、A方向)と略直交する方向(B方向;プリント配線板51 上のアンテナエレメント52とシールド部材53を結ぶ方向)に略平行な辺の一辺に設けられている。そして、コネクタ接続端子部55には、複数のコネクタ接続端子(電極パターン)56が形成されている。

このコネクタ接続端子56には、コネクタ60の接続端子(図示せず)が接続される。接続端子としては、例えば、グランド端子、電源端子、携帯電話端末と通信アダプタとの間を結ぶ複数の信号線用端子などが挙げられる。

[0036]

上述したように、コネクタ接続端子部55をB方向に略平行な辺の一辺に設けことで、携帯電話端末に接続した場合におけるアンテナのグランド長(4分の1波長相当)とアンテナエレメントとの関係は維持されるのでアンテナゲインに劣化は起こらない。

これは、コネクタ接続端子部55をA方向に略平行な辺の一辺に設けた場合には、具体的には、符号57で表されるように接続端子部を設けた場合には、通信アダプタのグランド端子が携帯電話のグランド端子とコネクタ接続端子を介して接続されることにより、グランドパターンの長さが4分の1波長より延長されて長くなるため、アンテナゲインの特性が維持されなくなるからである。この場合において、B方向にプリント基板50と同程度の幅を有するグランドパターンを設けることができればグランドとアンテナエレメントとより形成されるアンテナ装置のゲイン劣化は小さくなると思われるが、実際にはコネクタ接続端子を介してきわめて細い線材でグランド同士が接続されるような構造となるため、B方向にのみ線状に長さが増す構造となり、所定の特性より劣化することが考えられる

[0037]

図17は、図16に示したコネクタ60をプリント基板50に挿入して接続した通信アダプタモジュール70の外観斜視図である。

この通信アダプタモジュール70に、電池、ケース61などを追加組立てして 図18に示すように、通信アダプタ80(完成品)となる。

図19は、通信アダプタ80を携帯電話端末81に接続して使う場合の配置説 明図である。

携帯電話端末81の下部(図中、右側面に設けられた外部接続用コネクタ端子 (図示せず)と、通信アダプタ80のコネクタ端子82(図18参照)がお互い に挿入勘合され、電気的な接続が図られる。

[0038]

この場合、先に述べたように、本実施形態の構成によれば、携帯電話端末81と接続されることによる通信アダプタ80のアンテナ特性の劣化は起こらないこととなる。

図20は、携帯電話端末81を接続していない状態における通信アダプタ80 単体のアンテナ指向性特性図である。また、図21は、通信アダプタ80と携帯 電話端末81とを接続して得られるアンテナ装置の放射指向性特性図である。

ここで、図20および図21中、図の外周の1~16の数字は、一周360度を16等分した各方向を表しており、数字の現す実際の角度間隔は22.5度である。また、グラフ内の数値(dB値)はダイポールアンテナ比(dBd)である。

通信アダプタ80単体のアンテナ指向性特性は、図20に示すように、良好である。

[0039]

一方、通信アダプタ80と携帯電話端末81とを接続した場合のアンテナ指向性特性は、図21に示すように、接続したことによる特性劣化は無く、むしろゲインが向上していることがわかる。

上述した通信アダプタ80は、携帯電話端末31と接続され、所定の無線通信 技術により別の無線端末装置と組み合わせて用いられる。より具体的には、無線 通信技術としてのBluetooth、微弱無線等を用い、別の無線端末装置としてのヘッドセット、ハンズフリーセットなどと組み合わせて用いられ、車内における携帯電話のハンズフリーユニットとして用いられる。

また、室内・屋外等における近距離無線通信システムとして用いることもでき、これによって他の無線通信機器との間で情報通信が行われる。

すなわち、単体のアンテナ特性だけでなく、携帯電話端末と接続されて用いられる場合のアンテナ指向特性がより重要となり、このような用途に本実施形態の構成は非常に有効である。

[0040]

#### [6.2] 第5 実施形態

図22は、前述の第1~第4実施形態及び変形例に記載したプリント基板を用いた腕時計型(ウオッチ型)無線装置90の構成図である。

図22(a)は上面図、図22(b)は正面断面図、図22(c)は側面断面図である。

図22(b)に示すように、アンテナ装置94はシールド部材95が下側(腕側)となるように構成されている。この構成によれば、アンテナ装置94のシールド部材95と反対側に、ディスプレイ92にディスプレイ駆動用の信号を伝送するための導通ゴム93を設けるのに好都合となっている。

この導通ゴム93は、図22(c)に示すように、通常ディスプレイ92の上下(あるいは左右)に2つ(2系統)設けられる。

[0041]

さらに腕時計型無線装置90は、当該腕時計型無線装置90を構成する全部品がウオッチケース91に収納されている。

図22(b)に示すように、本第5実施形態は、シールド部材95が下に配置されているため、金属体である電池96を重ねて配置するのに適している。

この様に配置された電池96は、アンテナ装置94を構成するプリント配線板を平面とみなした場合に、その正射影がアンテナ装置94のグランドパターンの配置領域内に収まるようにすることが好ましい。

また、上記構成によれば、電池96の正極をシールド部材95を介して回路に

2 2

接続することが出来、小型化が可能である。

[0042]

## [6.3]第6実施形態

図23及び図24は、前述の第1~第4実施形態及び変形例に記載したプリント基板を用いたPDA (Personal Digital Assicetant;携帯型情報処理装置) 100、110の構成例の説明図である。

図23は第6実施形態のアンテナ装置101をPDA100の回路基板102 上にコネクタ等で接続する場合の構成例説明図である。図23(a)は平面図、 図23(b)は断面図である。

基板間コネクタ103及び104によりアンテナ装置101と回路基板102とを厚み方向に重ねて接続する。この場合において、アンテナ装置101と回路基板102との間は、所定距離以上離間していることが望ましい。例えば、数cm以上は離れていることが望ましい。そこで、本実施形態では、基板間コネクタ103、104の厚みを適宜設定することにより、回路基板102とアンテナ装置101との間隔を所定距離以上に設定している。

### [0043]

また、アンテナ装置101のアンテナエレメントに対向する回路基板102上 のパターンは、グランドパターン等のような大きなパターンでないことが望まし い。

なお、アンテナ装置101のアンテナエレメントを除く部分はシールド部材105によってシールドされている。また、PDA100の表面側にはディスプレイ106が備えられている。

図24は、第6実施形態のアンテナ装置111をPDA110の回路基板11 2に作りこむ場合のレイアウト例を説明する図である。図24(a)は、PDA 110を透視した平面図、図24(b)は断面図である。

## [0044]

回路基板112上に、アンテナ装置111を形成する領域を設け、この領域にはアンテナ装置111のみを形成する。回路基板112上の他の部分には本来のPDA回路113の配線パターンが形成されているが、PDA回路113とアン

テナ装置111とは、パターン接続部114のみを介して必要な信号線が接続されている。尚、アンテナ装置111のアンテナエレメントを除く部分はシールド部材115によってシールドされている。また、PDA110の表面側にはディスプレイ116が備えられている

このように形成することで、PDA回路113が形成されている同一の回路基板112上のレイアウトでありながら、アンテナの特性の劣化を小さく保つことが出来る。

[0045]

# [7] 実施形態の効果

上記各実施形態によれば、通信に用いる電波の波長をλとし、グランド部材として機能するシールド部材13の所定の方向軸Xに沿った長さLを略1/4λ(4分の1波長)としているので、アンテナ装置、ひいては、アンテナおよび無線通信回路を一体化したプリント基板のサイズをアンテナ特性を向上させつつ、小型にすることができる。

さらにシールド部材をグランドとして利用しているため、プリント配線板の面積が小さく十分なグランド面積を確保することができないような場合であっても、確実にグランド面積を確保することができ、アンテナ感度の劣化を抑制しつつ装置の小型化をはかり、実装密度を上げることができる。

[0046]

## 【発明の効果】

本発明によれば、アンテナ装置の特性を向上させつつ、アンテナ装置の小型化、ひいては、アンテナ装置が一体化されたプリント配線板あるいはプリント基板の小型化を図ることができる。ひいては、アンテナ装置を内蔵した通信アダプタおよび携帯型電子機器の小型化を図ることができる。

また、シールド部材をアンテナのグランドとして利用しているので、プリント 配線板の面積が小さく十分なグランド面積を確保することができない場合であっ ても、アンテナ感度の劣化を抑制しつつ、実装密度を上げることができ、小型の 無線通信機器を構成することができる。特に腕時計型無線通信機器(腕時計型の 携帯型電子機器)のように、小型化が切望される場合に適している。

# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 第1実施形態のプリント基板の組み立て図である。
- 【図2】 第1実施形態のプリント基板の上面図である。
- 【図3】 第1実施形態のプリント基板の正面図である。
- 【図4】 第1実施形態のプリント基板の側面図である。
- 【図5】 第1実施形態のアンテナ装置の放射特性の説明図である。
- 【図6】 比較対象のダイポールアンテナの放射特性の説明図である。
- 【図7】 比較対象のグランド部材として機能するシールド部材の所定の方向軸Xに沿った長さを略1/4 λ未満とした場合のアンテナ装置の放射特性の説明図である。
  - 【図8】 第2実施形態のプリント基板の組み立て図である。
  - 【図9】 第2実施形態のプリント基板の上面図である。
  - 【図10】 第2実施形態のプリント基板の正面図である。
  - 【図11】 第3実施形態のプリント基板の組み立て図である。
  - 【図12】 第3実施形態のプリント基板の上面図である。
  - 【図13】 第3実施形態のプリント基板の正面図である。
  - 【図14】 第4実施形態のプリント基板の上面図である。
  - 【図15】 第4実施形態のプリント基板の正面図である。
  - 【図16】 携帯電話端末に接続して用いる通信アダプタモジュール(第4 実施形態)の説明図である。
  - 【図17】 コネクタをプリント基板に挿入して接続した通信アダプタモジュールの外観斜視図である。
    - 【図18】 通信アダプタ(完成品)の外観斜視図である。
  - 【図19】 通信アダプタを携帯電話端末に接続して使う場合の配置説明図である。
  - 【図20】 携帯電話端末を接続していない状態における通信アダプタ単体のアンテナ指向性特性図である。
  - 【図21】 通信アダプタと携帯電話端末とを接続して得られるアンテナ装置の放射指向性特性図である。

# 特2003-157951

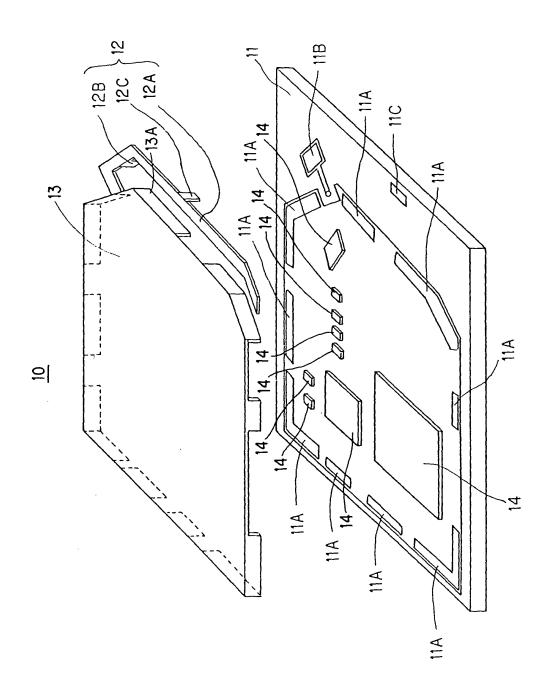
- 【図22】 腕時計型(ウオッチ型)無線装置の構成図である。
- 【図23】 PDAの構成例の説明図(その1)である。
- 【図24】 PDAの構成例の説明図(その2)である。

#### 【符号の説明】

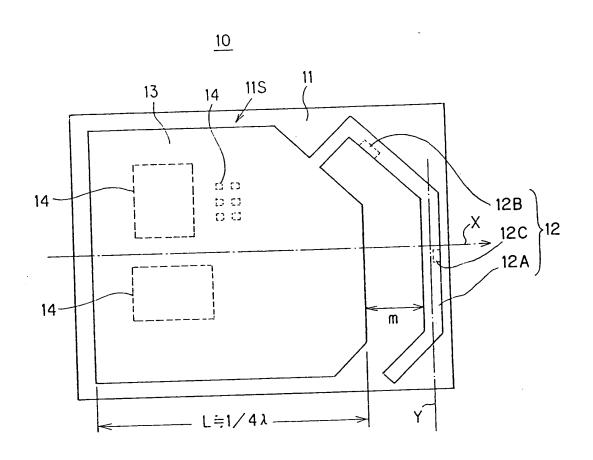
10、20、30……プリント基板、11、21、31……プリント配線板、11A、21A、31A……グランドパターン、12、22、32……アンテナエレメント、12A、22A、32A……アンテナエレメント本体、12B、22B、32B……給電端子、12C、22C……アンテナ本体支持部、13、23、33……シールド部材、14、24、34……電子部品(電子回路)、43……グランドパターン(グランド部材)、80……通信アダプタ、100、1100……アDA(携帯型電子機器)

【書類名】 図面

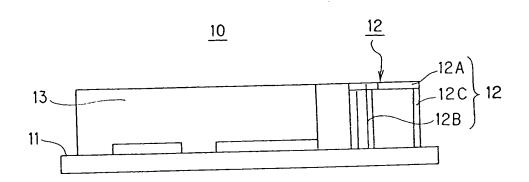
【図1】



【図2】

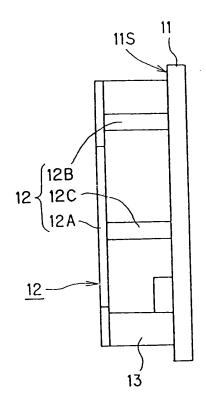


【図3】

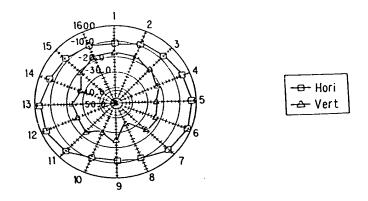


【図4】

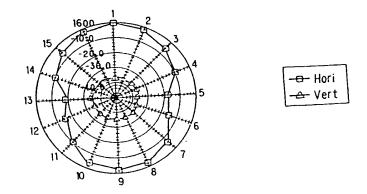
<u>10</u>



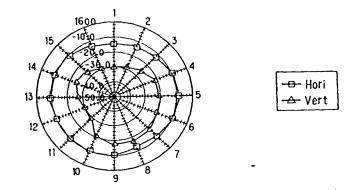
【図5】



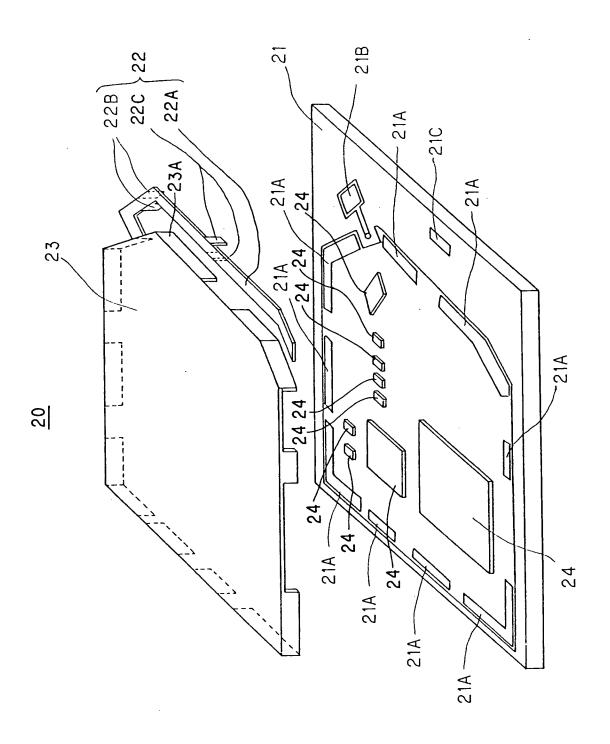
【図6】



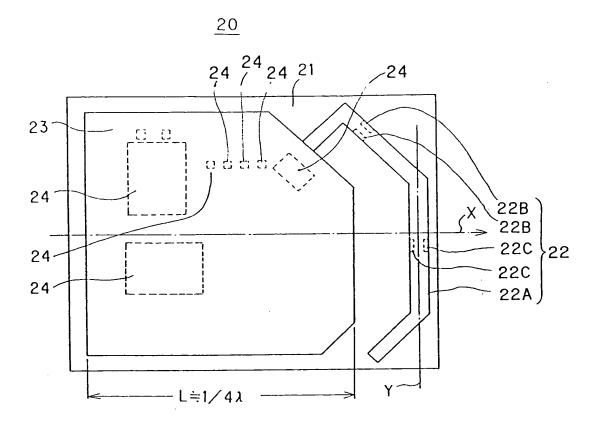
【図7】



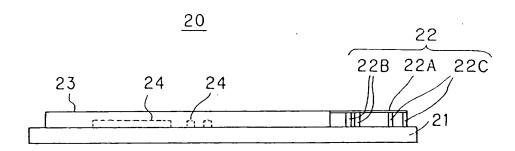
【図8】



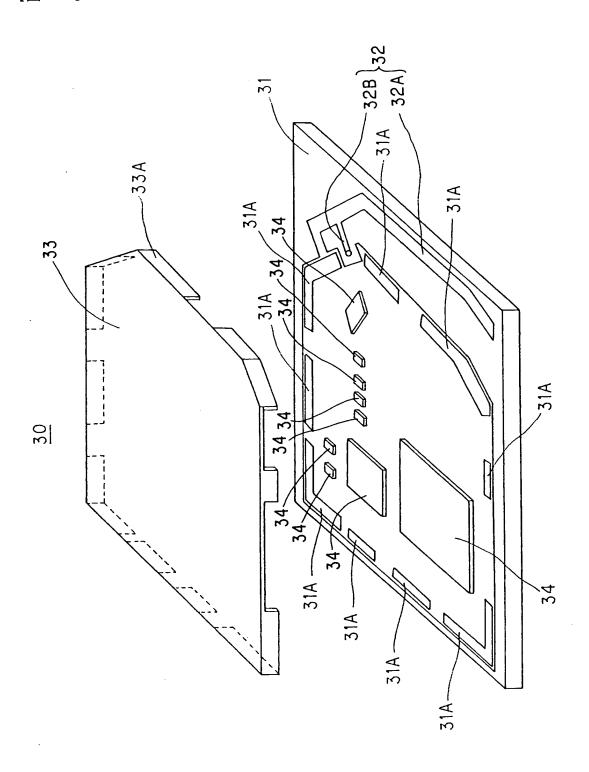
【図9】



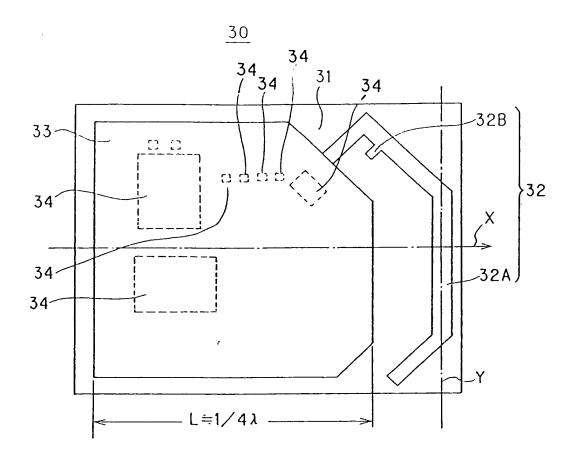
【図10】



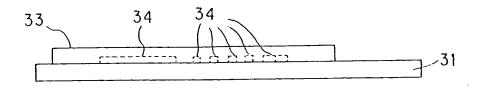
【図11】



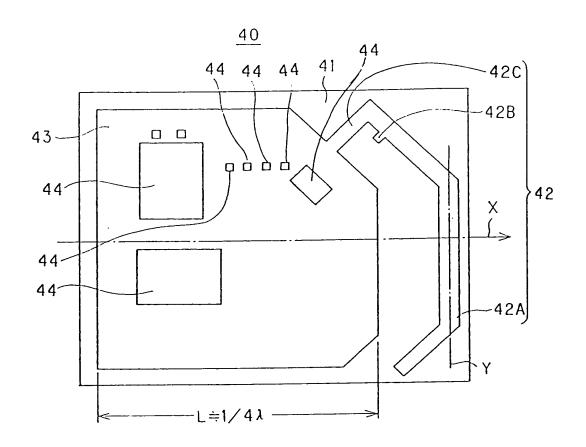
【図12】



【図13】

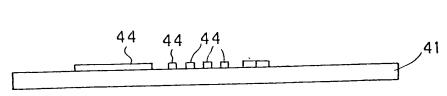


【図14】

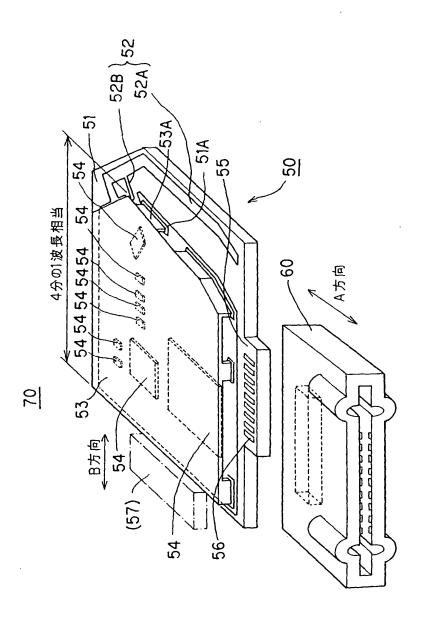


【図15】

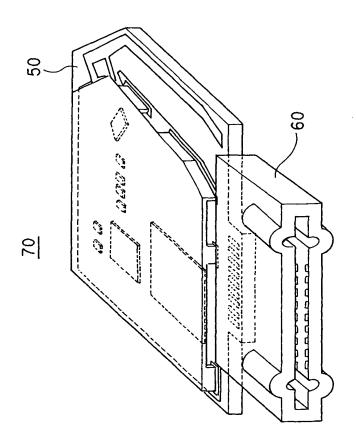




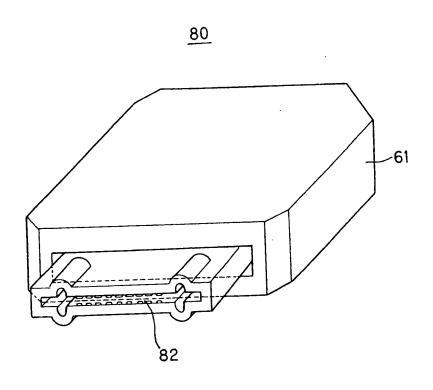
【図16】



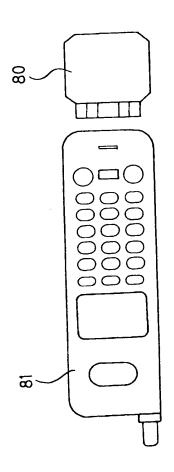
【図17】



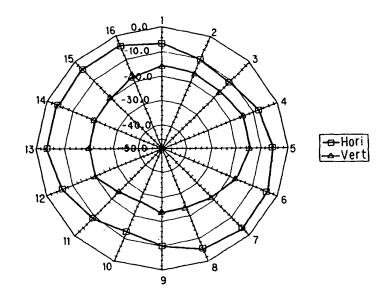
【図18】



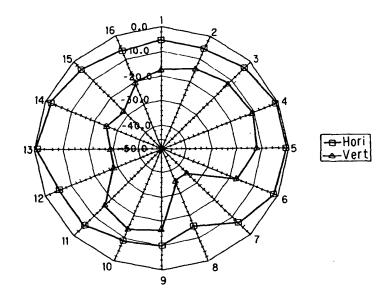
【図19】



【図20】



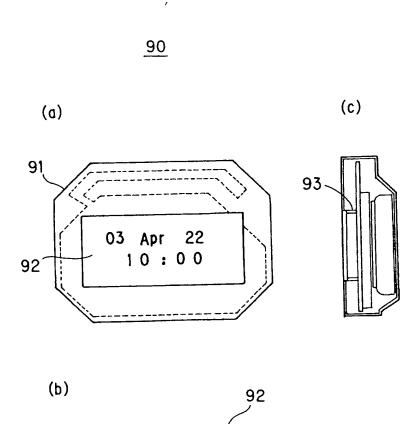
【図21】



[図22]

91

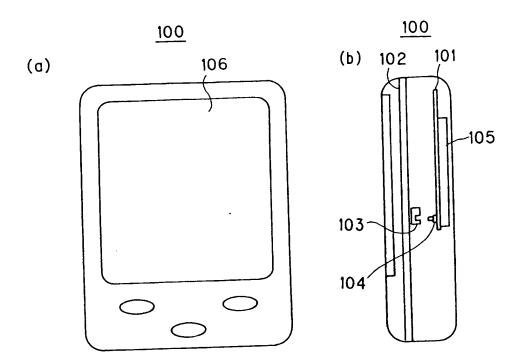
96



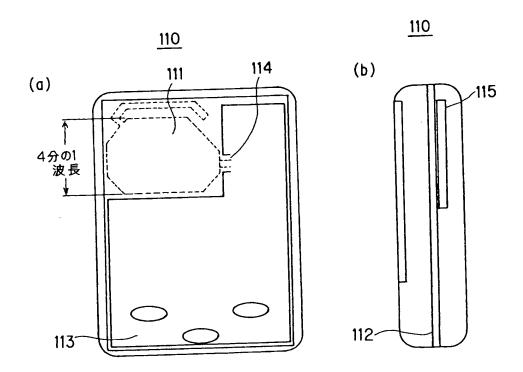
93

95

【図23】



【図24】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アンテナの特性(特に感度)を確保し、アンテナ装置、プリント配線板、プリント基板の小型化を図り、ひいては、通信アダプタおよび形態が電子機器の小型化を図る。

【解決手段】 プリント配線板11と、プリント配線板11上に配置された電子部品14と、プリント配線板11上に配置され、通信に用いる電波の波長をλとし、所定の方向軸Xに沿って略1/4 λ以上の長さを有するシールド部材 (グランド部材) 13と、方向軸Xと交差する方向に延在するように配置され、シールド部材 (グランド部材) に接地されたアンテナエレメント12と、を備える。

【選択図】 図1



## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-157951

受付番号

50300924913

書類名

特許願

担当官

第四担当上席

0093

作成日

平成15年 6月 6日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100091823

【住所又は居所】

東京都千代田区外神田6丁目16番9号 外神田

千代田ビル6階

【氏名又は名称】

櫛渕 昌之

【選任した代理人】

【識別番号】

100101775

【住所又は居所】

東京都千代田区外神田6丁目16番9号 外神田

千代田ビル6階

【氏名又は名称】

櫛渕 一江



## 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社